
未來計劃及[編纂]用途

未來計劃

有關我們未來計劃的詳細闡述，請參閱本文件「業務－我們的戰略」章節。

[編纂]用途

假設[編纂]為每股[編纂]港元（即指示性[編纂]範圍的中位數），並假設[編纂]未獲行使，於扣除所有[編纂]及與[編纂]相關的其他估計開支後，我們估計將自[編纂]收取[編纂]淨額約[編纂]百萬港元。

根據戰略及發展規劃，我們擬將[編纂]淨額按以下用途分配：

- (i) [編纂]淨額的約[編纂]%（相當於[編纂]百萬港元），將用於提高我們主要產品的產能及促進我們新產品的開發及商業化。
 - [編纂]淨額的約[編纂]%（相當於[編纂]百萬港元），將用於提高我們聲學增強材料、電子陶瓷材料及電子膠粘劑產品的產能，具體如下：
 - [編纂]淨額的約[編纂]%（相當於[編纂]百萬港元），將用於新購生產及檢測設備，以支持我們的生產擴張。
 - [編纂]淨額的約[編纂]%（相當於[編纂]百萬港元），將用於招聘生產人員，以確保交付效率及產品質量。
 - [編纂]淨額的約[編纂]%（相當於[編纂]百萬港元），將用於我們現有生產線的自動化升級、生產流程優化及數字化運營管理體系強化。該等舉措旨在加強我們的自動化及智能化能力，優化生產成本並提高生產效率。
 - [編纂]淨額的約[編纂]%（相當於[編纂]百萬港元），將用於促進我們新產品（包括新型N'BASS材料、隔膜、半導體設備用結構陶瓷粉體及其他產品）的開發及商業化：
 - [編纂]淨額的約[編纂]%（相當於[編纂]百萬港元），將用於新購關鍵生產設備。

未來計劃及[編纂]用途

- [編纂]淨額的約[編纂]% (相當於[編纂]百萬港元)，將用於招聘生產人員，以保障交付效率及產品質量。
- (ii) [編纂]淨額的約[編纂]% (相當於[編纂]百萬港元)，將用於建設我們的研發中心。我們計劃進一步拓展我們的產品在消費電子場景下的多元化應用覆蓋，加強功能增強材料在先進封裝、算力及其他半導體相關領域等高增長行業中的開發及應用，同時推進信息化系統的開發。
- [編纂]淨額的約[編纂]% (相當於[編纂]百萬港元)，將用於建設我們的研發中心，包括陶瓷粉體技術中心、有機粉體及高分子材料技術中心、分析測試中心及新技術孵化中心。該等資金將用於收購及翻新我們研發中心的樓宇、招聘研發人員及購買研發及測試設備。
 - [編纂]淨額的約[編纂]% (相當於[編纂]百萬港元)，將用於產學研及職能中心的翻新以及人員招聘。
 - [編纂]淨額的約[編纂]% (相當於[編纂]百萬港元)，將用於建設及升級一套涵蓋研發、生產營運、財務及其他職能的綜合信息系統。
- (iii) [編纂]淨額的約[編纂]% (相當於[編纂]百萬港元)，將用於未來進行潛在的併購。有關詳情，請參閱本文件「業務－我們的戰略－開展戰略性併購，提升綜合競爭力」。
- (iv) [編纂]淨額的約[編纂]% (相當於[編纂]百萬港元)，將用於拓展我們的銷售及服務網絡，主要用於招募具備專業技術背景的销售人員；及
- (v) [編纂]淨額的約[編纂]% (相當於[編纂]百萬港元)，將用作營運資金及一般公司用途。

倘[編纂]釐定於指示性[編纂]範圍中位數之上或之下，分配至上述用途的[編纂]淨額將按比例相應調整。因行使[編纂]而收取的任何額外[編纂]，亦將按比例分配至上述用途。

倘[編纂]釐定為每股[編纂][編纂]港元(即本文件所述[編纂]範圍的上限)，且假設[編纂]未獲行使，我們將收取約[編纂]百萬港元的額外[編纂]淨額。倘[編纂]釐定為

未來計劃及[編纂]用途

每股[編纂][編纂]港元（即本文件所述[編纂]範圍的下限），且假設[編纂]未獲行使，我們收取的[編纂]淨額將減少約[編纂]百萬港元。

倘我們[編纂][編纂]淨額的用途與上述內容出現任何重大變動，或各用途的[編纂]淨額分配比例出現任何重大變動，我們將作出正式公告。倘[編纂][編纂]淨額未即時用於上述用途，我們僅會將該等[編纂]淨額存入持牌商業銀行及／或其他獲授權金融機構（定義見證券及期貨條例或其他司法管轄區的適用法例及規例）的短期有息賬戶。